Warszawa, 24.09.2019

Zapytanie w celu oszacowania wartości zamówienia polegającego na dostawie urządzenia – wire bonder półautomatyczny

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Elektronowej zwraca się z prośbą o przedstawienie informacji dotyczących szacunkowych kosztów realizacji niżej opisanego zamówienia.

UWAGA!
Niniejsze szacowanie wartości zamówienia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem ani zapytaniem o cenę w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat kosztów realizacji opisanej dostawy.

I. ZAMAWIAJĄCY

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Elektronowej
al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w ramach projektu „Centrum Nanoelektroniki, Mikrosystemów i Fotoniki" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.

Przedmiotem zamówienia będzie półautomatyczne urządzenie do wykonywania połączeń drutowych. Narzędzie powinno być dedykowane do prac badawczo-rozwojowych oraz produkcji mało/średnio seryjnej.

Oferowane urządzenie musi umożliwiać / zapewniać:

- Pracę w trybie manualnym i automatycznym;
- Powierzchnię roboczą stołu: 150 mm x 150 mm;
- Głowicę do połączeń drutowych typu klin – klin (ang. wedge-wedge) i kulka – klin (ang. ball-wedge), termo i ultrakompresji;
- Wykonywanie połączeń klinowych: drutem Al, Au: 17µm – 75µm, Pt: 25 µm; taśmą: Au, Al: 25x125µm;

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Elektronowej
al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
Tel.: +48 22 548 78 15, Fax: +48 22 847 06 31, E-mail: dyrektor@ite.waw.pl, www.ite.waw.pl
NIP: 525-000-91-11, KRS: 0000055975, REGON: 000038971, Nr rejestrowy: BDO 000012276
Konto bankowe: mBank S.A. 47 1140 1977 0000 5580 4500 1001

- Wykonywanie połączeń kulka – klin (ang. ball-wedge): drut Au 17µm – 50µm, Pt: 25 µm;
- Odstęp pomiędzy polami montażowymi (ang. bond pad pitch): 60 µm;
- Wykonywanie połączeń drutowych do pół montażowych (ang. bond pad opening): 50 µm;
- Technikę rozpoznawania obrazu (ang. pattern recognition);
- Dokładność pozycjonowania (ang. placement accuracy): ±5µm (w trybach ręcznym i automatycznym);
- Powtarzalność (ang. repeatability): ±5µm;
- Grzanie podłoża do temperatury 200°C;
- Możliwość definiowania i zapisywania procedur wykonywania połączeń
- Mikroskop

Oferujący musi dostarczyć podstawowe procedury wykonywania połączeń drutami Al, Au oraz Pt (włącznie z procedurą wykonywania połączeń do platynowych (Pt) pól montażowych).

III. ELEMENTY WYCENY

W wycenie Wykonawca powinien zawrzeć:

1) nazwę, adres Wykonawcy, osobę do kontaktów;
2) cenę w zł (netto i brutto) uwzględniającą wszystkie koszty dostawy.

Wzór formularza wyceny stanowi załącznik nr 1 do niniejszego szacowania wartości zamówienia.

IV. FORMA SKŁADANIA WYCENY

Elektronicznie na adres: mntlab@ite.waw.pl

V. TERMIN SKŁADANIA WYCENY

8 października 2019 r. godz. 16:00

VI. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW

Dariusz Szmigiel

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Elektronowej

Oddział w Piasecznie

ul. Okulickiego 5E

05-500 Piaseczno

+48 22 27 93 200

e-mail: szmigiel@ite.waw.pl